

SiCパワーMOSFET搭載 ACEPACK DMT-32モジュール



OBC & DC-DCコンバータ向け 高い柔軟性と小型化を実現するパワー・モジュール



エネルギー損失と高スイッチング周波数動作の最適なバランスを提供

ACEPACK DMT-32は、デュアル・インライン構造モールド・タイプでスルーホール実装のオールインワン・パワーモジュールです。電気自動車およびハイブリッド車のオンボード・チャージャ(OBC)や補助DC-DCコンバータの各段をはじめ、太陽光発電やエネルギー、モータ・ドライブ用途にも対応します。

このパワー・モジュールは、小型サイズながら高い設計自由度を備え、複数のトポロジー構成に対応可能です。ジグザグピン配置オプションにより、PCB実装も容易になります。

DBC基板により優れた放熱性能を確保するとともに、フルモールド・パッケージによって高い堅牢性と信頼性を実現しています。また、沿面距離を向上させるための特殊な溝構造を採用しています。

特徴

- AQG-324準拠
- 耐圧: 1200V & 650V*
- 高いパワー密度と高効率を実現するSiC MOSFET パワー・スイッチ
- 最大ジャンクション温度: 175°C
- 熱性能を向上させるAlN ベースDBC基板
- 絶縁耐圧: 3.5kV AC/60秒
- 成形モジュールに施した特殊溝により沿面距離を拡大
- インラインおよびジグザグのピン配置オプション
- NTCセンサ内蔵

アプリケーション

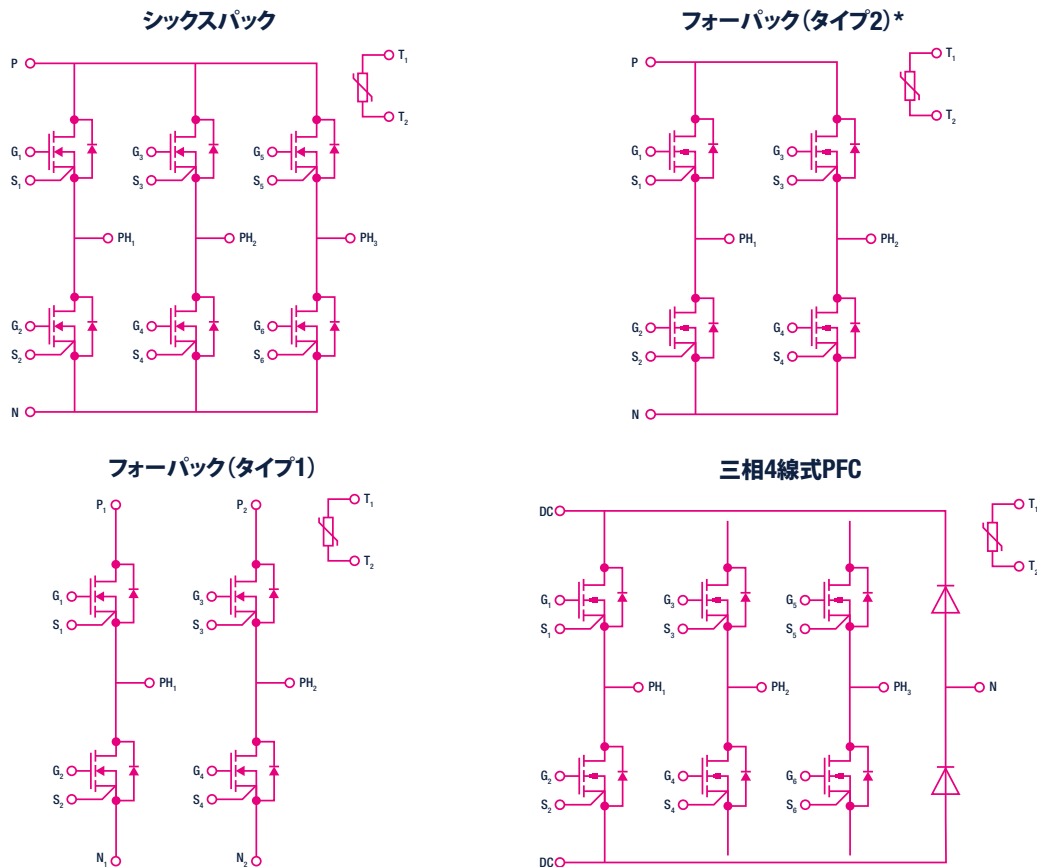
- オンボード・チャージャ (OBC)
- HEV / EV向けDC-DCコンバータ
- 流体ポンプ
- HVAC
- アクティブ・サスペンション

* 開発中

ACEPACK DMT-32パワー・モジュールは、SiC第2世代および第3世代* MOSFET技術を採用し、シックスパック、フォーパック、三相4線式PFC コンバータの構成をサポートします。高い電力密度と効率が求められるアプリケーションにおいて、開発期間の短縮に貢献します。

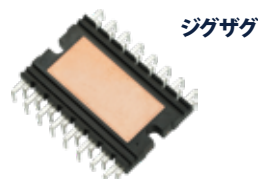
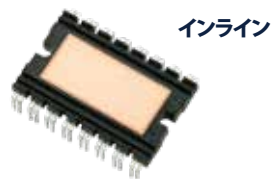
また、このパワー・モジュールは、4~22kW の出力レンジ、650V*~1200V の耐圧範囲に対応します。

ACEPACK DMT-32トポロジ



* 開発中

ピン配置オプション



詳細情報



© STMicroelectronics - May 2026 - Printed in Japan - All rights reserved
 STMicroelectronicsのロゴマークは、STMicroelectronics Groupの登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者に帰属します。
 STの登録商標についてはSTウェブサイトをご覧ください。: www.st.com/trademarks
 STマイクロエレクトロニクス株式会社 ■東京 TEL 03-5783-8200 ■大阪 TEL 06-6397-4130 ■名古屋 TEL 052-587-4547

